



News Release

多様なアプリケーションで活用される Optical Package のソリューションを提供いたします

テンピ、アリゾナ、2018年12月3日 — 半導体のパッケージング及びテストサービス (OSAT) のリーディングカンパニーである Amkor Technology, Inc. (Nasdaq: AMKR) は、本日、成長著しい Optical 市場に対応する MEMS およびセンサーパッケージのプラットフォーム拡張を発表いたしました。新製品の Optical パッケージのプラットフォームは、実績ある ChipArray® BGA および MicroLeadFrame®ファミリーの派生品であり、LIDAR、指紋センサー、照度センサー、3次元顔認証など幅広い用途にお使いいただけます。

Amkor Technology の Corporate Vice President である John Donaghey は以下のように述べています。

「Amkor は自動車、通信および民生品向けの MEMS およびセンサーの製造及びテストについて 25 年を超える実績を有しています」「当社の大規模な MEMS 及びセンサーパッケージのプラットフォームをさらに拡張する事で、Optical 市場からのご要求にお応えする事を楽しみにしています。これにより、お客様が自社のソリューションを迅速に市場へ投入するための最適なサービスを提供することができると考えています」

Amkor の工場は IATF16949 の認定を受けており、また AEC-Q100 の要件も満たしています。Amkor のフルターンキー Optical MEMS 及びセンサーソリューションは、デザイン、組立およびテストのすべてに対応可能です。Amkor の Optical MEMS、センサーパッケージについての詳細は

www.amkor.com/technology/optical-sensors/をご覧ください。

About Amkor Technology, Inc.

Amkor Technology, Inc. は、半導体のパッケージングとテストサービス企業 (OSAT) として世界最大規模の企業の一つです。1968 年の設立以来、IC パッケージングとテストのパイオニアとして研鑽を重ね、現在では 250 を超える世界有数の半導体企業、ファウンドリー、エレクトロニクス OEM の戦略的パー



News Release

トナーとなっています。Amkor は、アジア、ヨーロッパ、米国の主要なエレクトロニクス製造地域において、1100 万平方フィートの床面積を誇る製造拠点、開発センター、営業&サポートオフィスを展開しています。詳細は www.amkor.com をご覧ください。

###

Key Words

OSAT

Semiconductor packaging

Advanced IC packaging

組立、テスト

Optical センサーパッケージング

Optical センサーテスト

ヘテロジニアスインテグレーション

MEMS

MOEMS

センサー

BGA

ChipArray®

MicroLeadFrame®

Contacts

Investor Relations

Chris Chaney

Vice President, Investor Relations

480-786-7594

Media Relations

Debi Polo

Senior Manager, Marketing Communications

+1-480-786-7653

Social Media: @amkortechology